

国際会議 Second Circular 案内

主催 日本鉄鋼協会

International Conference on Computer-assisted Materials Design and Process Simulation (COMMP '93)

本会では標記国際会議を 1993 年 9 月に東京において開催いたしますが、会議組織委員会（委員長 新居和嘉金属材料技術研究所所長）では Second Circular を発行しております。ご入用の方は下記 8 へご請求願います。

1. 会議の名称

- (和文名) 材料設計およびプロセス工学へのコンピューター利用国際会議
(英文名) International Conference on Computer-assisted Materials Design and Process Simulation
(略称) COMMP '93

2. 会期 1993 年 9 月 6 日 (月) から 9 日 (木) までの 4 日間

3. 会場 日本都市センター (東京都千代田区平河町)

4. 会議トピックス

I. Process Simulation

- I-1 Transport and Rate Phenomena
Reduction, Refining, Casting
- I-2 Structural Evolution
Solidification, Welding, Joining, Thermomechanical processing
- I-3 Solid Engineering
Plastic forming, Powder forming, Mechanical alloying
- I-4 Novel Materials Processing
Thin film fabrication, Surface modification, Amorphization, Micro-gravity processing, STM processing

II. Materials Design

- II-1 Prediction of Fundamental Properties
Mechanical properties, Electronic and Magnetic properties, Thermodynamic properties
- II-2 Characterization and Design of Microstructure
Phase diagram, Phase transformation, Recrystallization, Pattern formation,
Interface and grain boundary
- II-3 Structural Materials
High strength alloys, Heat-resistant alloys, High damping alloys, Metal matrix composites,
Nuclear materials
- II-4 Functional Materials
Shape memory alloys, Rare earth magnet, Magnetic steel sheet *etc.*
- II-5 Reliability Evaluation
Fatigue, Creep, Corrosion, Fracture, Life Prediction, Nondestructive evaluation, Radiation damage

III. Fundamental Tools for the Process and Materials Design

Materials characterization, Artificial reality, Neural network, Special purpose processor, Data base, Knowledge base

5. 会議用語 : 英語 (通訳なし)

6. 会議 Proceedings : 会議当日参加者全員に配布

7. 参加登録費 : 60,000 円 (会員) 70,000 円 (非会員)

8. 連絡・問合せ先 :

Second Circular ならびに本会議に関するお問合せは下記宛お願いいたします。

〒100 東京都千代田区大手町 1-9-4 経団連会館 3 階 (社)日本鉄鋼協会 国際室 COMMP '93 係
TEL 03-3279-6021 FAX 03-3245-1355